

ADVANTEST®

2024年度（2025年3月期） 第3四半期 決算説明会

2025年1月29日
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ご注意

会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。

サマリー

[FY24 3Q業績]

- 売上高/営業利益/当期利益： 四半期ベースの過去最高を記録
 - ✓ コア部品に対する既存サプライヤーとの長期契約や、サプライチェーン複線化などの施策を通じ、タイムリーな部材調達および製品供給能力の確保に努め、想定を上回る製品出荷を実現
 - ✓ 対米ドルの為替が想定より円安となったことも追い風 (FY24 3Q 1米ドル=想定 140円、実績 149円)

[今後の見通し]

- FY24 通期業績： 業績予想を上方修正
 - ✓ SoCを中心とするAI関連の旺盛なテスト需要は継続。増強した製品供給能力により従来予想に織り込み切れなかった需要増にも追従
- CY25 半導体テスト市場見通し： 後半に不透明感はあるものの、引き続き強いテスト需要を見込む
 - ✓ AI関連半導体の複雑化および生産拡大を背景に、引き続き強いテスト需要を見込む
 - ✓ AI関連半導体以外の市場向け半導体テスト需要回復は、なお時間を要すると予想

2024年度第3四半期 決算報告

經營執行役員 CFO & CSO (Chief Strategy Officer)

經營戰略本部長

三橋 靖夫

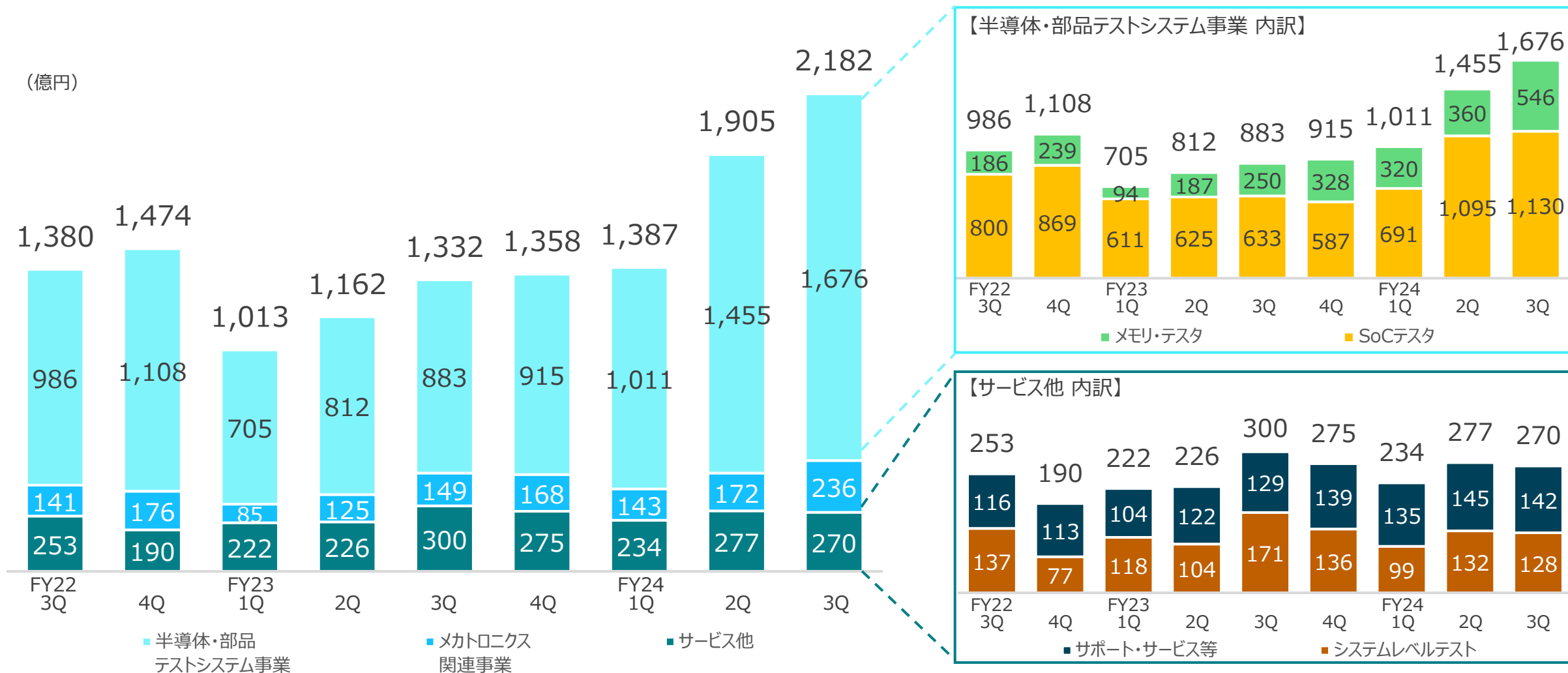
四半期業績推移

(億円)

	FY23				FY24						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前期比		前年同期比	
								増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	1,013	1,162	1,332	1,358	1,387	1,905	2,182	+277	+14.5%	+849	+63.7%
売上総利益	510	580	674	696	769	1,101	1,189	+88	+8.0%	+515	+76.4%
売上総利益率	50.3%	49.9%	50.6%	51.3%	55.4%	57.8%	54.5%	-3.3pts		+3.9pts	
営業利益	143	210	268	195	313	636	692	+57	+9.0%	+424	2.6x
営業利益率	14.1%	18.1%	20.1%	14.4%	22.6%	33.4%	31.8%	-1.6pts		+11.7pts	
税引前四半期利益	130	203	263	186	319	607	706	+98	+16.2%	+443	2.7x
四半期利益	92	167	212	152	239	454	519	+64	+14.1%	+307	2.4x
四半期利益率	9.1%	14.4%	15.9%	11.2%	17.2%	23.9%	23.8%	-0.1pts		+7.9pts	
為替レート (円)	1米ドル	135	142	149	147	153	154	149	5円 円高		-
	1ユーロ	146	156	159	159	165	168	162	6円 円高		3円 円安
1株当たり配当額*1 (円)	-	16.25 (65)	-	18	-	19	-			-	-

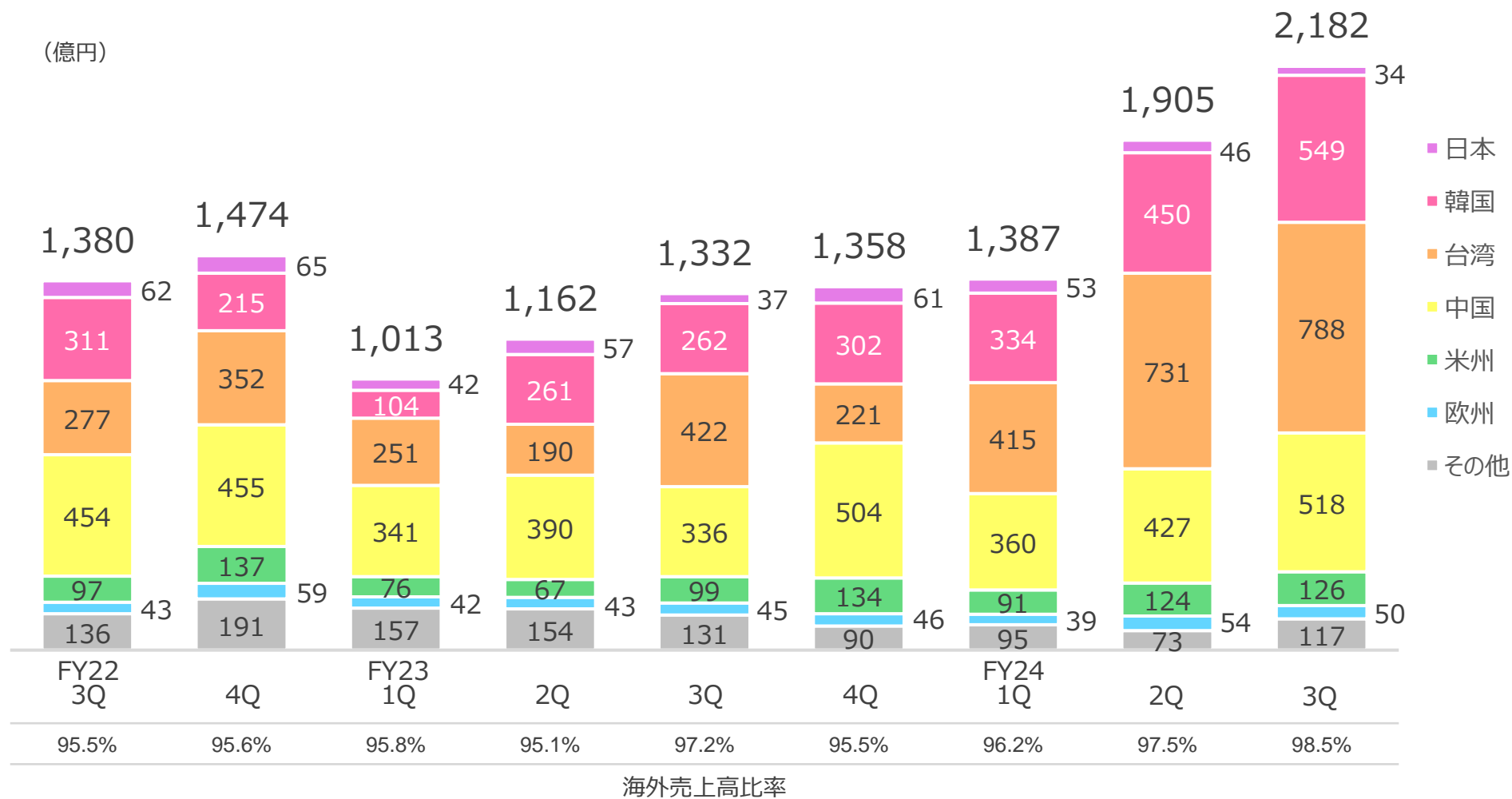
*1:当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。上記1株当たり配当金はFY23期首に株式分割が行われたと仮定しての数値を記載しております。(カッコ内は分割前の値)

四半期売上高 事業セグメント別

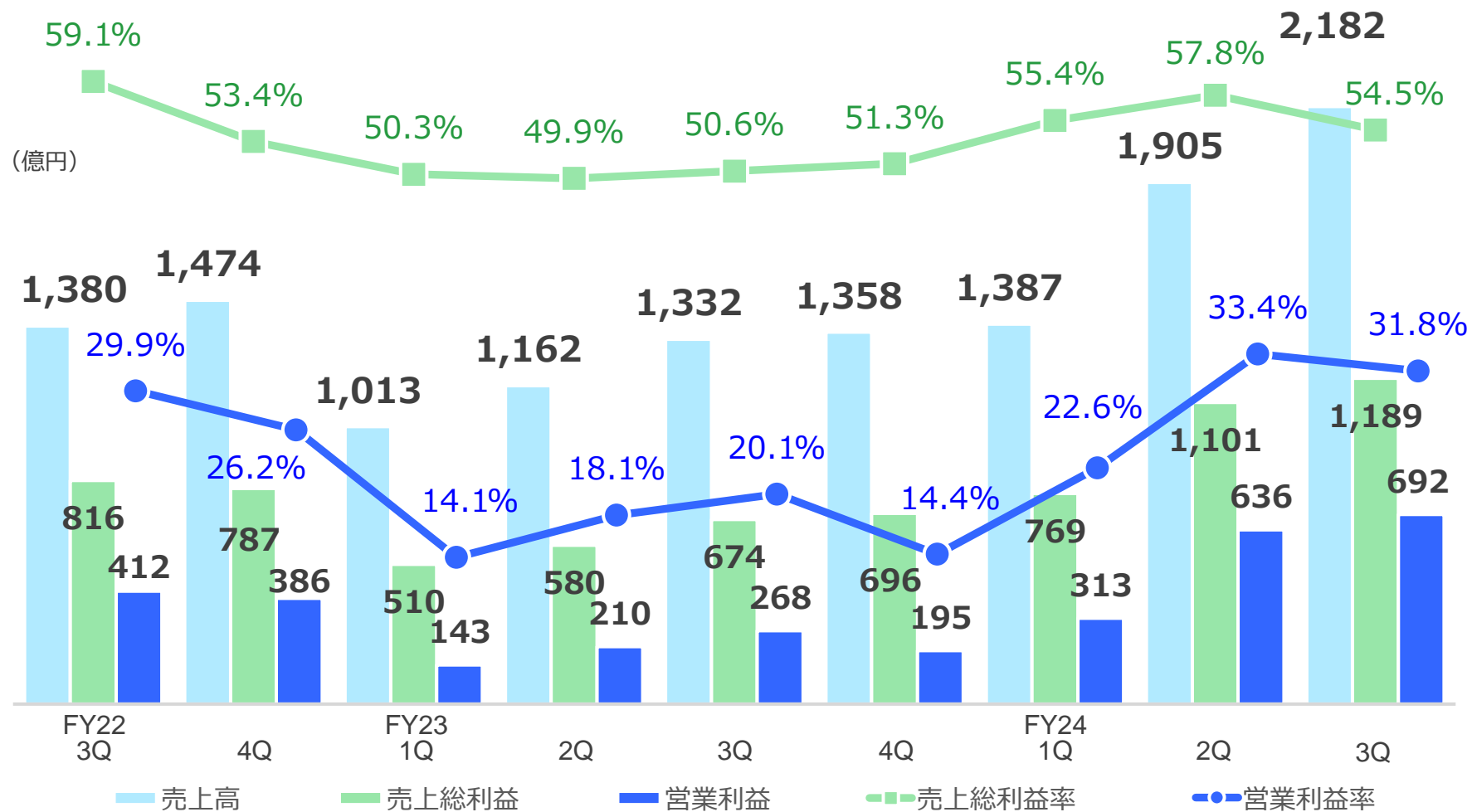


*合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

四半期売上高 地域(出荷先)別



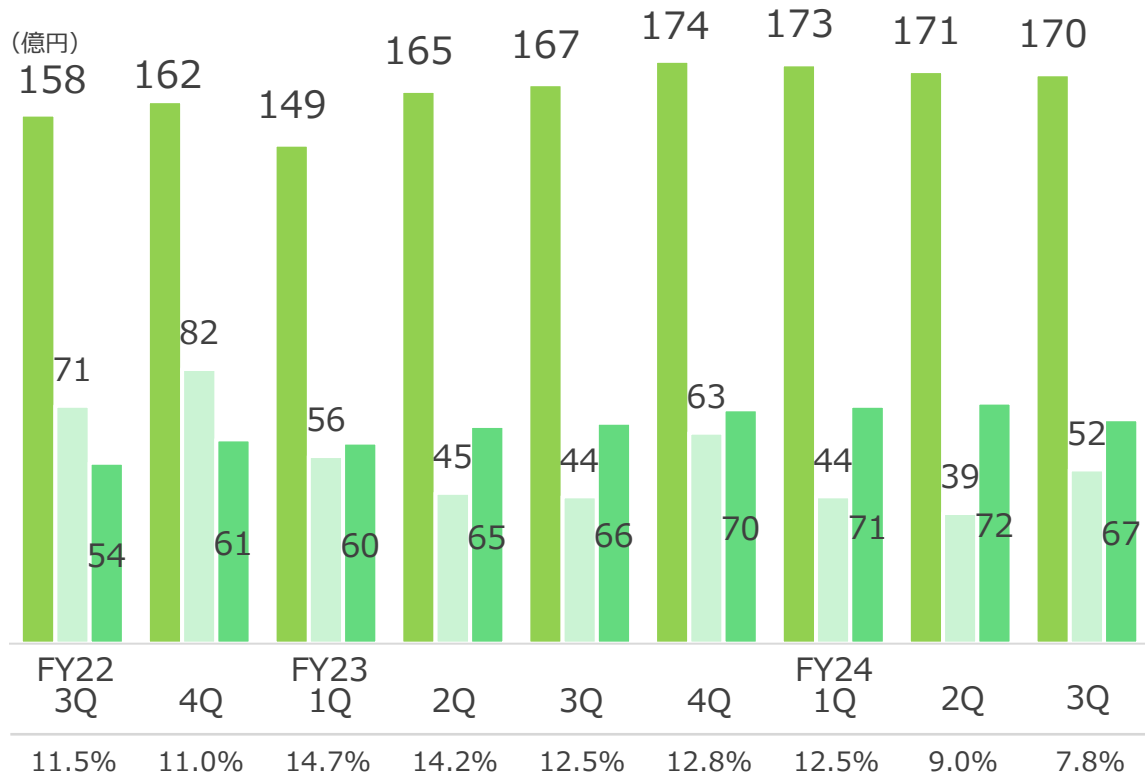
売上高/売上総利益/営業利益



投資等/キャッシュ・フロー

<投資等>

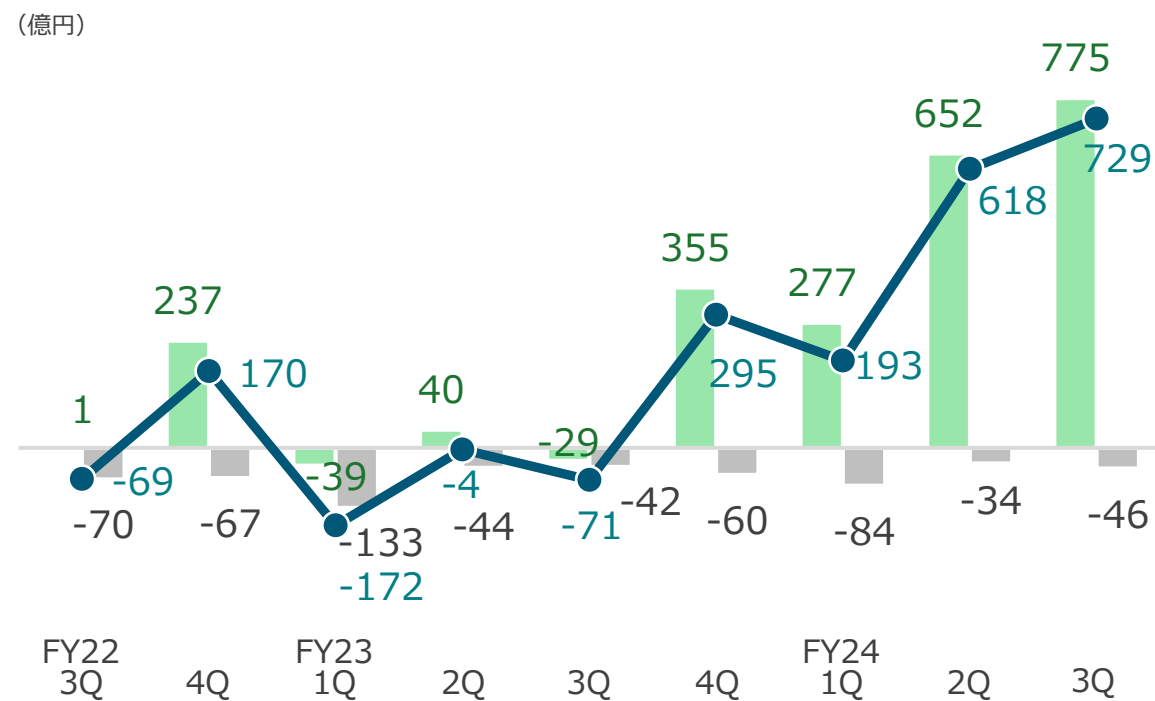
- 研究開発費
- 設備投資
- 減価償却費



研究開発費売上高比率

<キャッシュ・フロー>

- 営業キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- フリー・キャッシュ・フロー

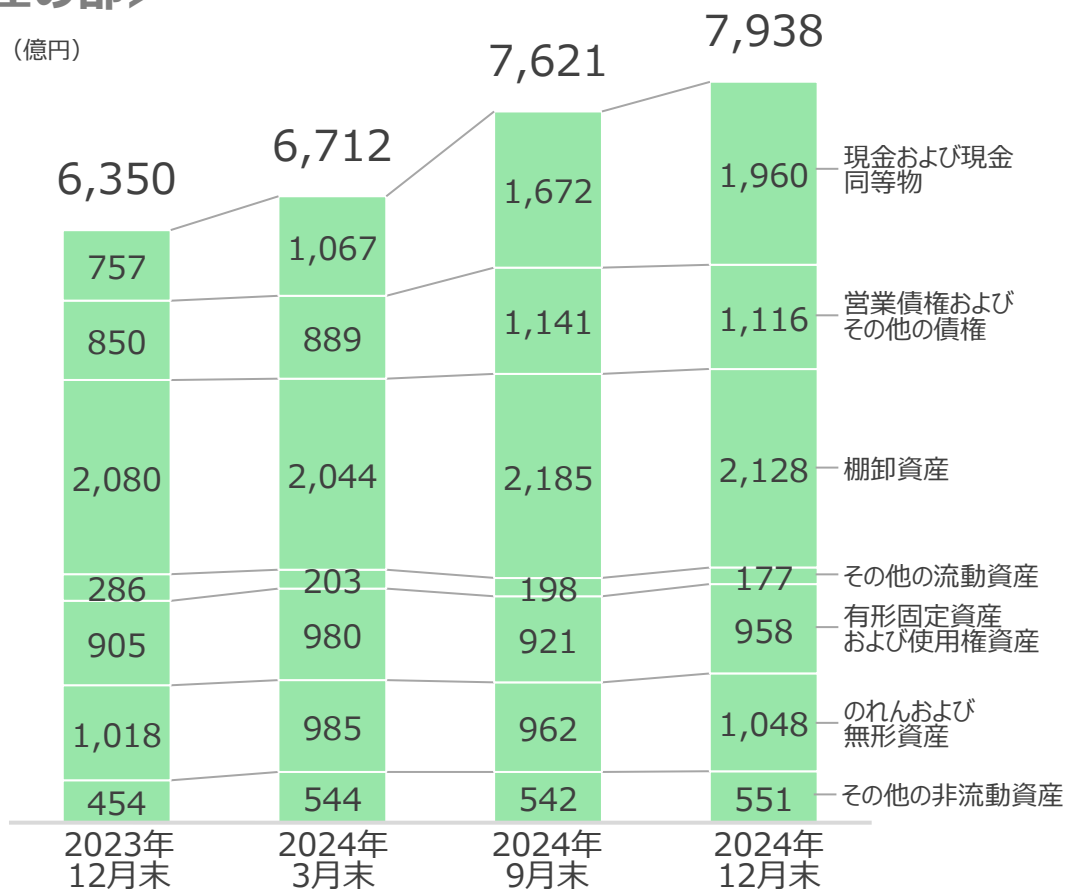


*フリー・キャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

連結財政状態

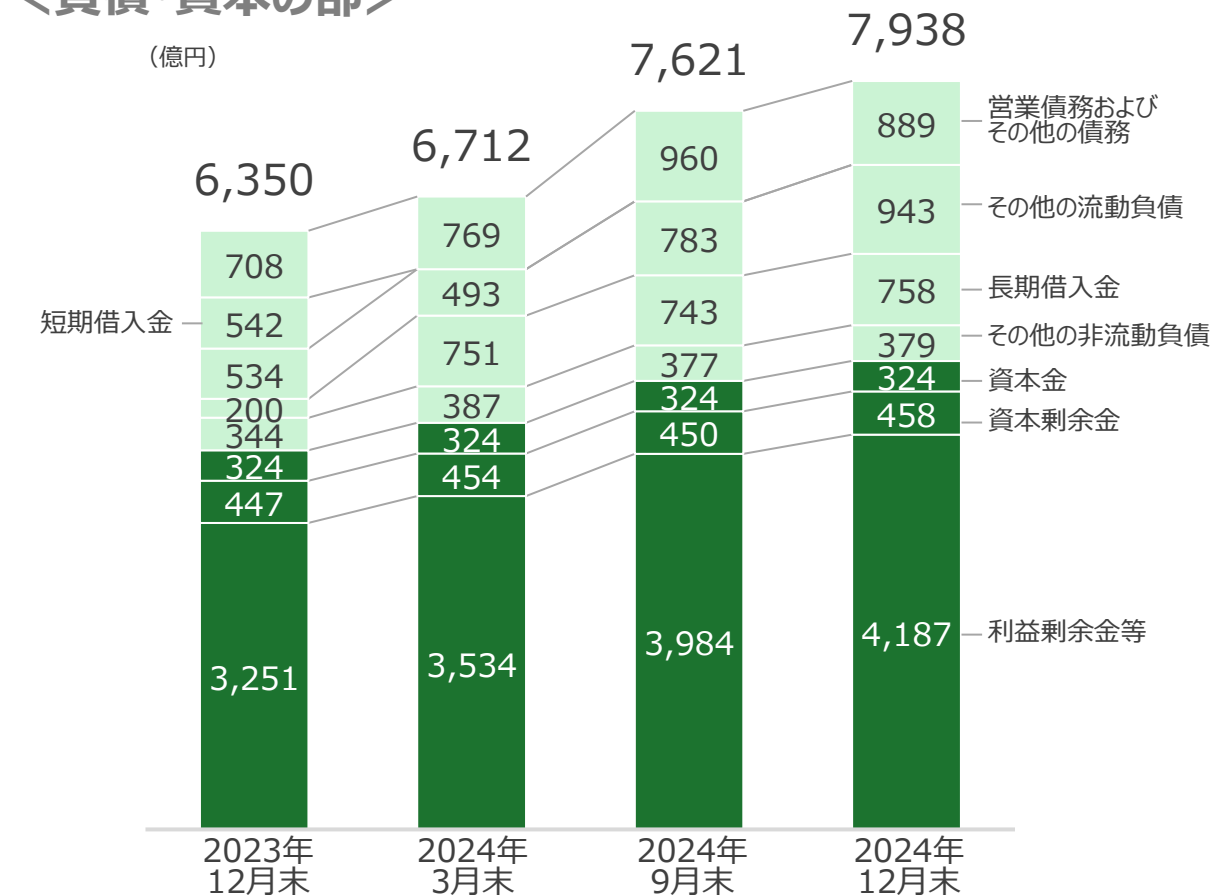
<資産の部>

(億円)



<負債・資本の部>

(億円)



親会社の所有者に帰属する持分	4,022	4,312	4,758	4,969
親会社所有者帰属持分比率	63.3%	64.2%	62.4%	62.6%

2024年度事業見通し

代表取締役 兼 経営執行役員
Group CEO

Douglas Lefever

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ADVANTEST[®]

事業環境と半導体テスト市場の動向 <2025年1月時点の見方>

CY25 事業環境

- 半導体市場は、CY24に引き続き、主にAI関連向けが半導体需要をけん引すると予想
- 一方、地政学リスクの上昇に伴い、先行きの不確実性が増加

CY25 半導体テスト市場

- CY24の市場規模は、当社のテスト供給能力増強を中心に、前回推定値から引き上げ
- CY25は、AI関連向けテストの高水準な需要は継続すると見込むが、自動車や産業機器向けなどのテスト需要回復にはなお時間を要する見通し

	CY23実績	CY24実績（暫定）	CY25推定
SoCテスト市場	約\$3.3B	約\$3.9B - 4.0B (2024年10月時点推定: 約\$3.5B - 3.8B)	約\$4.2B - 4.8B
メモリ・テスト市場	約\$1.1B	約\$1.9B - 2.0B (2024年10月時点推定: 約\$1.7B - 1.9B)	約\$1.7B - 2.2B

Source: Advantest

FY24業績予想

(億円)

	FY23 実績	FY24						vs. FY23		(参考)新旧FY24予想比較	
		1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 予想	通期予想	増減額	増減率	2024年 10月時点	修正額	
売上高	4,865	1,387	1,905	2,182	1,926	7,400	+2,535	+52.1%	6,400	+1,000	
営業利益	816	313	636	692	619	2,260	+1,444	2.8x	1,650	+610	
営業利益率	16.8%	22.6%	33.4%	31.8%	32.1%	30.5%	+13.7pts		25.8%	+4.7pts	
税引前利益	782	319	607	706	618	2,250	+1,468	2.9x	1,625	+625	
当期利益	623	239	454	519	463	1,675	+1,052	2.7x	1,220	+455	
当期利益率	12.8%	17.2%	23.9%	23.8%	24.0%	22.6%	+9.8pts		19.1%	+3.5pts	
基本的EPS*1 (円)	84.45	32.35	61.56	70.30	63.53	227.74	+143.29	2.7x	165.01	+62.73	
研究開発費	655	173	171	170	206	720	+65	+9.9%	720	-	
設備投資	208	44	39	52	75	210	+2	+1.0%	220	-10	
減価償却費	261	71	72	67	60	270	+9	+3.4%	270	-	
為替レート*2	1米ドル	143	153	154	149	149	6円 円安		147	2円 円安	
	1ユーロ	155	165	168	155	163	8円 円安		161	2円 円安	

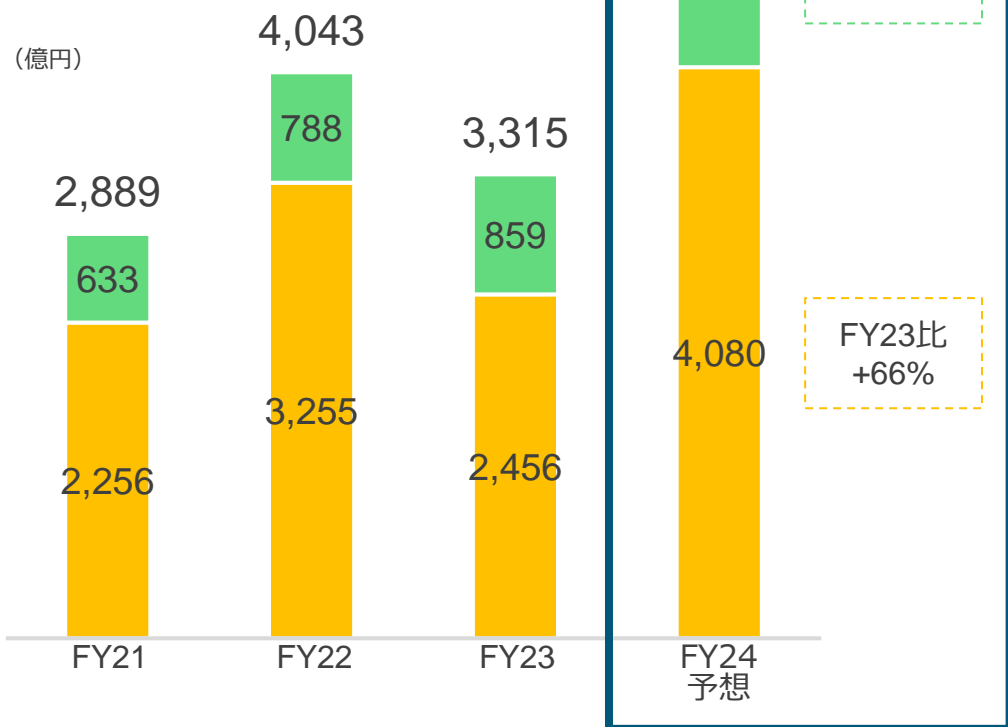
*1: 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。上記の基本的EPSはFY23期首に株式分割が行われたと仮定しての数値を記載しています。業績予想における「基本的EPS」は、2024年12月31日現在の「期末発行済株式数(自己株式を含む)」から「期末自己株式数」を除いた株式数を、期中平均株式数とみなして算定しております。また、FY24 4Q業績予想の数値は通期予想からFY24 3Qまでの実績を差し引き、算出しております

*2: 為替レート変動が今年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+13億円です。対ユーロは-3億円です

FY24見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム事業
売上高推移

- メモリ・テスト
- SoCテスト



半導体・部品テストシステム事業

<SoCテスト>（2024年10月予想比 +840億円）

- HPC/AI向け顧客の納期要求に追従すべく、製品供給ペースを引き上げ、売上見通しを増額

アプリケーション別内訳	FY21	FY22	FY23	FY24(予)
コンピューティング・通信	60%	65%	60%	90%
車載・産業機器・民生・DDIC*	40%	35%	40%	10%

* DDIC:ディスプレイ・ドライバーIC

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

<メモリ・テスト>（2024年10月予想比 +90億円）

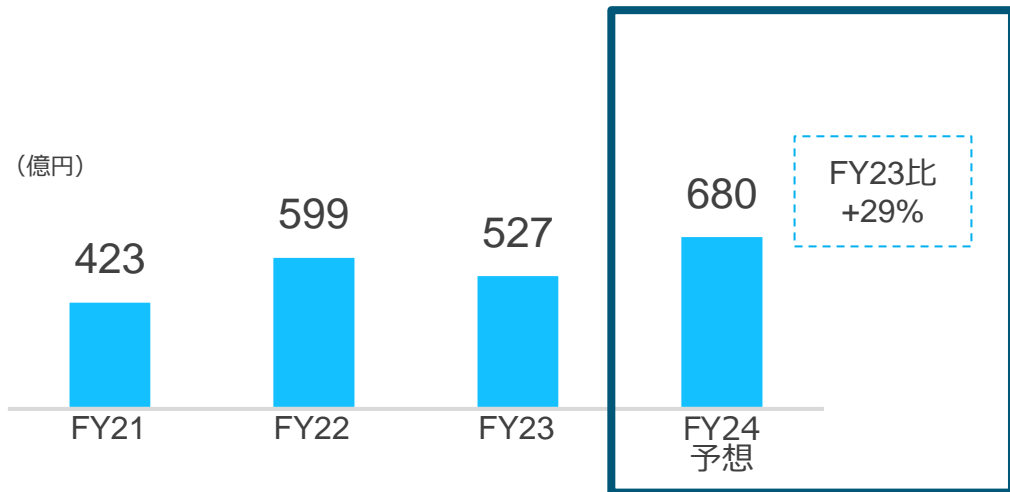
- 当社の製品供給体制を段階的に整備し、DRAM向けの顧客の旺盛な投資意欲に対応

アプリケーション別内訳	FY21	FY22	FY23	FY24(予)
DRAM	60%	60%	90%	95%
不揮発性メモリ	40%	40%	10%	5%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

FY24見通し（事業別）

メカトロニクス関連事業 売上高推移



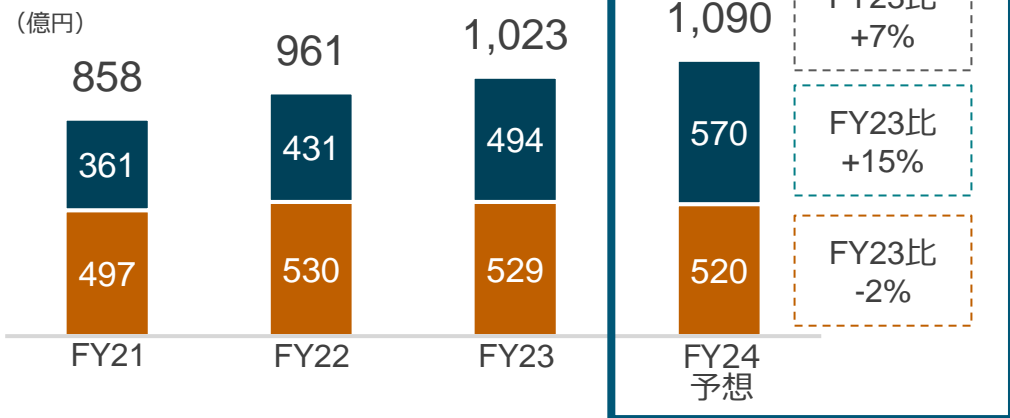
メカトロニクス関連事業

(2024年10月予想比 +30億円)

- テスタ需要増と連動し、デバイス・インタフェースの売上は前年度比で増加見通し
- ナノテクノロジー製品も堅調な販売を見込む

サービス他 売上高推移

■ サポート・サービス等
■ システムレベルテスト



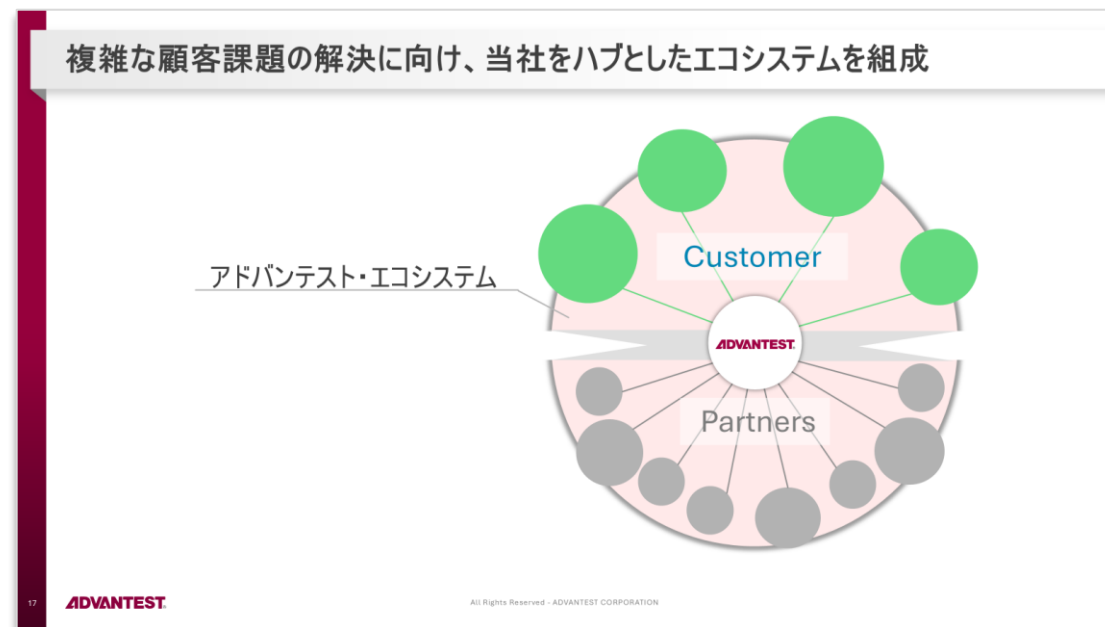
サービス他事業

(2024年10月予想比 +40億円)

- 当社製品の設置台数の着実な伸びにより、サポート・サービスの需要は堅調
- システムレベルテストは、スマートフォン需要の不透明感継続を背景に前年度並みの売上を見込む

戦略的パートナーシップ契約を締結

- Technoprobe社およびFormFactor社との戦略的パートナーシップ契約を締結 (2025年1月9日発表)
 - ✓ 技術およびプリント基板(PCB)製造に関する協業を含む
 - ✓ 主要プローブカード・メーカーである両社への投資およびパートナーシップにより、顧客が信頼性の高いプローブカード・メーカーにアクセスできる環境を確保
 - ✓ 同時に、当社は技術協力を通じて顧客の将来ニーズに応える高性能なテスト・ソリューション実現を図る
 - ✓ 主にHPC(High Performance Computing)用半導体などにおいて、テストの複雑性増加が業界課題
 - ✓ 当社は、この課題解決に向け、当社をハブとしたエコシステムを組成し、顧客により高性能なテスト・ソリューション提供を図る方針



▲中長期経営方針説明会資料より(2024年6月25日)

ADVANTEST®